

惠州市思凯表面处理材料有限公司

Huizhou SKY Surface Treatment Materials Co., Ltd

环保碱铜工艺说明书

一、特点

- 1、具有良好的结合力,可作为锌合金、铝合金、钢铁件及铜合金件的预镀铜。
- 2、镀层细致, 孔隙少, 深镀能力好, 电流效率高。挂滚镀都适用。
- 3、镀液成分简单,稳定性好,电流范围宽,杂质容忍度高,易于生产控制。
- 4、镀液成分均属一般化学品,危害性小,利于改善生产环境。
- 5、氰化镀铜与环保镀铜可直接转(切)换,无需额外处理。

二、工艺参数

	挂	镀	滚	镀
项目	标准范围	最佳值	标准范围	最佳值
环保络合剂	$110-200 \mathrm{g/L}$	$140 \mathrm{g/L}$	$120220\mathrm{g/L}$	$180 \mathrm{g/L}$
环保铜盐	$17-31\mathrm{g/L}$	21g/L	$18-33 \mathrm{g/L}$	28g/L
Cu [⁺]	11-20g/L 14g	/L	12-22g/L 18	g/L
P 比 (络合剂:	Cu ⁺) 9-11: 1	10: 1	9-11: 1	10: 1
光剂	0.2-1m1/L			0.5m1/L
走位剂	15m1/L			3.5m1/L
温度	45−55°C			50°C
PH	10.5-12.5	11.5	10. 5-12. 5	11.5
阴极电流密度	05-1.0A/dm2			
阳极电流密度	≤0.3A/dm2			
阳极	无氧电解铜角((铜球)		
阳极: 阴极	2-4: 1, 为维持	F阴阳极面积	只比,应适当增减阳相	汲或辅助阳极
过滤	镀液连续过滤,	过滤量≥8	次/h	

三、镀液配制方法

- 1、开槽前,镀槽需用5%的稀硫酸浸泡一两天,清水洗净,再用5%的碱液中和,洗净备用。
- 2、镀槽中加入 50%的纯水,加温至 50℃,将开槽量的络合剂均匀倒入槽中,搅拌至彻底溶解。
- 3、将开槽量的铜盐用少量水调成糊状,均匀加入镀槽,搅拌至溶解完全。保温 4-6 小时,使镀液成分充分络合。
- 4、补加纯水至工作液位,以 2-3g/L 的活性炭碳吸附后过滤干净。
- 5、以 0.15-0.2A/dm² 的电流电解镀液 4 小时左右,将开槽所需要量的光剂慢慢加入槽中,搅拌 均匀进行试镀,试镀正常后即可投入生产。

四、镀液成分与工艺参数的影响

- 1、环保铜盐:提供给镀液中铜离子的主盐,金属含量为 65.5%,铜离子过高,镀层粗糙,走位差。铜离子低,阴极效率低,沉积速度慢。维持铜离子含量的稳定主要控制阴阳极面积比。根据铜离子变化适当增减阳极或辅助阳极。
- 2、环保络合剂:铜离子的络合主盐。消耗量 1000-1500g/KA•H. 主要作用是细化结晶,提高 镀层均匀性、深镀能力,保证阳极正常溶解。镀液中需维持一定量的游离络合剂。络合剂 低,电流高区粗糙,低区暗哑,阳极易钝化。络合剂过高,电流效率低,沉积速度慢。一般控制 P 比(络合剂: Cu+)在 8.5-12 之间。
- 3、光剂:适量的光剂使镀层呈半光亮的均匀镀层。消耗量 150-300m1/KA•H,光剂少,光亮度差,光剂过量,镀层易变色。阳极溶解异常。
- 4、温度:适当提高温度可提高电流效率,增加光亮范围。
- 5、PH 值: PH 过低, 镀层易产生颗粒, 毛刺。提高 PH 值用氢氧化钾调整。
- 6、阳极电流密度:阳极电流密度过高,铜阳极易钝化。应维持一定的阳极面积。

五、镀液维护

- 1、为保证电镀质量, 电镀工件入槽前应充分的净化与活化。
- 2、镀液应连续过滤,定期以活性炭碳吸处理,防止有机杂质积累。
- 3、镀液成分浓度高,为避免带出损耗大,原材料异常消耗,应尽量做好回收利用。
- 4、定期分析镀液成分,作赫氏槽试片。依据分析结果及时调整镀液成分, 持在工艺范围内。

六、常见故障及外理方法

<u> </u>				
故障现象	产生原因及处理方法			
	1、镀液中铜离子浓度低,适当补加铜盐			
 沉积速度很慢	2、镀液中铜离子、络合剂偏离工艺范围,根据分析			
<i>①14</i> 次还/交1区 閏	结果补加铜盐、络合剂			
	3、镀液中混入铬杂质,用保险粉处理			
	1、工件前处理不良,加强前处理			
镀层起泡	2、铜离子与络合剂比例不正常,分析调整			
	3、锌合金材质不良,压铸不良,孔隙大			
辞艮战	1、镀液成分比例失调,分析调整镀液			
镀层烧焦	2、电流过大,适量调整电流			
四十四四十二十五四十二十五四十二	1、阳极电流密度过大,增加阳极面积			
阳极附近电解液 发蓝	2、镀液流动交换差			
及监	3、游离络合剂不足,分析补充			
HP 하기 기 사항	1、铜阳极面积过大,适当减少铜阳极面积			
铜离子上升,镀 层粗糙	2、控制 P 比在工艺范围内			
広 性健	3、PH 过低,用氢氧化钾调整			
	1、P 比失调,铜高络合剂低,分析调整镀液成分			
神巴目気ル	2、适当增加辅助阳极,减少铜阳极,逐步降低铜离			
镀层易氧化	子至工艺规范			
	3、光剂过量、有机杂质高,电解或碳吸处理			

七: 镀液成份含量分析方法

1、络合剂分析方法

一、试剂

- 1.1 碘标准溶液(0.1mo1/L)
- 1.2 EDTA 溶液 (10g/L)
- 1.3 柠檬酸铵溶液 (250g/L)
- 1.4 淀粉指示剂(10g/L)

二、分析步骤

- 1.1 取 10mL 镀液,并定容至 100mL
- 1.2 取 5mL 1.1 定容后的络合剂溶液于 250mL 锥形瓶, 加 80mL 蒸馏水
- 1.3 在锥形瓶中加 5mL EDTA 溶液 (10g/L)
- 1.4 在锥形瓶中加 5mL 柠檬酸铵溶液 (250g/L)
- 1.5 在锥形瓶中加入1mL 淀粉指示剂(1%)
- 1.6 使用 Ⅰ2 标准溶液滴定络合剂溶液。直至蓝色不消失,反应完全, 记录消

耗的 I2标准

溶液体积

计算**方**法

络合剂 (g/L)=C1*V1*173.91

C1--I2 标准溶液的摩尔浓度

V1-滴定所消耗 I2标准溶液体积 mL

2、铜离子含量分析方法

一、试剂

- 2.1 过硫酸铵: 固体
- 2.2 无水
- 2.3 柠檬酸铵溶液: 250g/L
- 2.4 NH₄Cl-NH₃H₂O PH 缓冲溶液
- 2.5 EDTA 标准滴定溶液: 0.02mol/L
- 2.6 PAN 指示剂:1g/L

二、检测方法

- 2.1 取 10mL 电镀液, 定容至 100mL, 摇匀。
- 2.2 取 10mL 定容液于 250mL 锥形瓶中,放置于通风橱内加入过硫酸铵 1g,

摇匀至完全溶解,加热煮沸至溶液呈淡蓝色,冷却至室温。

- 2.3 加入柠檬酸铵溶液 10mL 摇匀。
- 2.4 加入 PH 缓冲溶液 10mL 摇匀。
- 2.5 加入蒸馏水 80mL 摇匀。
- 2.6 加入无水乙醇 5mL 摇匀。
- 2.7 加入 1 滴管 PAN 指示剂摇匀。
- 2.8 使用 EDTA 标准滴定溶液进行滴定,直到溶液由紫红色变为淡黄色为滴定终点。

计算方法

 $Cu^+(g/L)=C1\times v1\times 6$

3.54

C1--EDTA 标准滴定液的浓度(mol/L)

V1--滴定时消耗的 EDTA 标准滴定溶液体积 (mL)

声明: 此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数,是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性,故本公司不保证及不负责任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。